Rockchip RK3358 Linux SDK 快速入门

文件标识: RK-JC-YF-360

发布版本: V1.8.1

日期: 2022-11-20

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因、本文档将可能在未经任何通知的情况下、不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要介绍 Rockchip RK3358 Linux SDK 的基本使用方法,旨在帮助开发者快速了解并使用 RK3358 Linux SDK 开发包。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot 版本	Debian 版本	Yocto 版本
RK3358M/RK3358J	2018.02-rc3	N/A	N/A

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	WJL	2021-12-30	初始版本。
V1.8.0	WJL	2022-06-16	版本同步至 V1.8.0。
V1.8.1	Caesar Wang	2022-11-20	更新刷机说明

目录

Rockchip RK3358 Linux SDK 快速入门

- 1. 开发环境搭建
- 2. 软件开发指南
 - 2.1 开发向导
 - 2.2 软件更新记录
- 3. 硬件开发指南
- 4. SDK 配置框架说明
 - 4.1 SDK 工程目录介绍
 - 4.2 SDK 板级配置
 - 4.3 查看编译命令4.4 自动编译
 - 4.5 各模块编译及打包
 - 4.5.1 U-Boot 编译
 - 4.5.2 Kernel 编译
 - 4.5.3 Recovery 编译
 - 4.5.4 Buildroot 编译
 - 4.5.5 交叉编译
 - 4.5.5.1 SDK 目录内置交叉编译链
 - 4.5.5.2 Buildroot 内置交叉编译
 - 4.5.6 固件的打包
- 5. 刷机说明
 - 5.1 Windows 刷机说明
 - 5.2 Linux 刷机说明
 - 5.3 系统分区说明
- 6. 快速启动
- 7. OTP
- 8. RK3358 SDK 固件

1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译, 其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外,还有其他软硬件方面的要求:

硬件要求: 64 位系统, 硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建, 将需要更大的硬盘空间。

软件要求: Ubuntu 20.04 系统:

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下:

```
sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
   g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
   qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
   g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev
```

建议使用 Ubuntu 20.04 系统或更高版本开发, 若编译遇到报错, 可以视报错信息, 安装对应的软件包。

2. 软件开发指南

2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》,可在 docs 下获取,并会不断完善更新。

2.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看, 具体方法如下:

```
.repo/manifests$ realpath rk3358_linux_release.xml
# 例如: 打印的版本号为 v1.8.0, 更新时间为 20220620
# <SDK>/.repo/manifests/rk3358_linux_release_v1.8.0_20220620.xml
```

软件发布版本更新内容通过工程文本可以查看, 具体方法如下:

```
.repo/manifests$ cat RK3358_Linux_SDK_Release_Note.md
```

或者参考工程目录:

```
<SDK>/docs/RK3358/RK3358_Linux_SDK_Release_Note.md
```

3. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考用户使用指南, 在工程目录:

RK3358 硬件设计指南:

<SDK>/docs/RK3358/Hardware/Rockchip_RK3358J_Hardware_Design_Guide_V1.0_CN.pdf

RK3358 EVB 硬件开发指南:

<SDK>/docs/RK3358/Hareware/Rockchip_RK3358J_User_Manual_EVB_V1.0_CN.pdf

4. SDK 配置框架说明

4.1 SDK 工程目录介绍

SDK 目录包含有 buildroot、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或 其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- app: 存放上层应用 APP。
- buildroot: 基于 Buildroot (2018.02-rc3) 开发的根文件系统。
- device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external: 存放第三方相关仓库,包括音频、视频、网络、recovery等。
- kernel: 存放 Kernel 4.4/4.19 开发的代码。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。

4.2 SDK 板级配置

进入工程 /device/rockchip/rk3358 目录:

板级配置	说明
BoardConfig-rk3358-evb-ddr3-v10.mk	适用于 RK3358 EVB V10 搭配 DDR3 开发板
BoardConfig-rk3358m-vehicle-ddr3.mk	适用于 RK3358 Vehicle 搭配 DDR3 开发板
BoardConfig.mk	默认配置

方法一:

./build.sh 后面加上板级配置文件, 例如:

选择 RK3358 EVB DDR3 V10 的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3358/BoardConfig-rk3358-evb-ddr3-v10.mk

选择 RK3358M Vehicle DDR3 的板级配置:

./build.sh device/rockchip/rk3358/BoardConfig-rk3358m-vehicle-ddr3.mk

方法二:

```
rk3358$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-rk3358-evb-ddr3-v10.mk
2. BoardConfig-rk3358m-vehicle-ddr3.mk
3. BoardConfig.mk
Which would you like? [0]:
....
```

4.3 查看编译命令

在根目录执行命令: ./build.sh -h|help

```
rk3358$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk -switch to specified board config
lunch
                  -list current SDK boards and switch to specified board config
                  -build uboot
uhoot
uefi
                  -build uefi
spl
                  -build spl
loader
                  -build loader
kernel
                   -build kernel
modules
                  -build kernel modules
toolchain
                  -build toolchain
rootfs
                   -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot
                  -build buildroot rootfs
ramboot
                   -build ramboot image
multi-npu_boot
                  -build boot image for multi-npu board
                   -build yocto rootfs
yocto
debian
                  -build debian rootfs
pcba
                   -build pcba
recovery
                   -build recovery
all
                   -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
                   -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
cleanall
firmware
                  -pack all the image we need to boot up system
updateimg
                   -pack update image
                   -pack ab update otapackage image (update_ota.img)
otapackage
sdpackage
                   -pack update sdcard package image (update_sdcard.img)
                   -save images, patches, commands used to debug
save
allsave
                   -build all & firmware & updateimg & save
```

```
check
                  -check the environment of building
info
                  -see the current board building information
                   -build packages in the dir of app/*
app/<pkg>
external/<pkg>
                  -build packages in the dir of external/*
createkeys
                  -create secureboot root keys
security_rootfs
                  -build rootfs and some relevant images with security paramter
(just for dm-v)
security_boot
                  -build boot with security paramter
                 -build uboot with security paramter
security_uboot
security_recovery -build recovery with security paramter
security_check
                 -check security paramter if it's good
Default option is 'allsave'.
```

查看部分模块详细编译命令,例如: ./build.sh -h kernel

```
rk3358$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 px30_linux_defconfig rk3358_linux.config
make ARCH=arm64 rk3358-evb-ddr3-v10-linux.img -j12
```

4.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译:

```
./build.sh all # 只编译模块代码(u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery)
# 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh # 在./build.sh all基础上
# 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
# 2. update.img打包
# 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
# 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
# 注: ./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

4.5 各模块编译及打包

4.5.1 U-Boot 编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

4.5.2 Kernel 编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

4.5.3 Recovery 编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注: Recovery是非必需的功能,有些板级配置不会设置。

4.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip_rk3358/images下生成 rootfs.ext4。

4.5.5 交叉编译

4.5.5.1 SDK 目录内置交叉编译链

SDK prebuilts 目录预置交叉编译,如下:

目录	说明
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu	gcc arm 6.3.1 64位工具 链
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf	gcc arm 6.3.1 32位工具 链

4.5.5.2 Buildroot 内置交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。比如 RK3358,其交叉编译工具位于 buildroot/output/rockchip_rk3358/host/usr 目录下,需要将工具的 bin/ 目录和 aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/ 目录设为环境变量,在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本:

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看:

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3358/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息:

```
aarch64-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.02-rc3-XXXXXX) 10.3.0
# XXXXXX 为 Buildroot 最新 commit ID
```

比如编译 busybox 模块, 常用相关编译命令如下:

• 编译 busybox

```
SDK$ make busybox
```

• 重编 busybox

```
SDK$ make busybox-rebuild
```

• 删除 busybox

```
SDK$ make busybox-dirclean
或者
SDK$ rm -rf /buildroot/output/rockchip_rk3358/build/busybox-1.34.1
```

4.5.6 固件的打包

上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后,进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

```
./mkfirmware.sh
```

5. 刷机说明

RK3358 EVB V10 接口分布图如下:

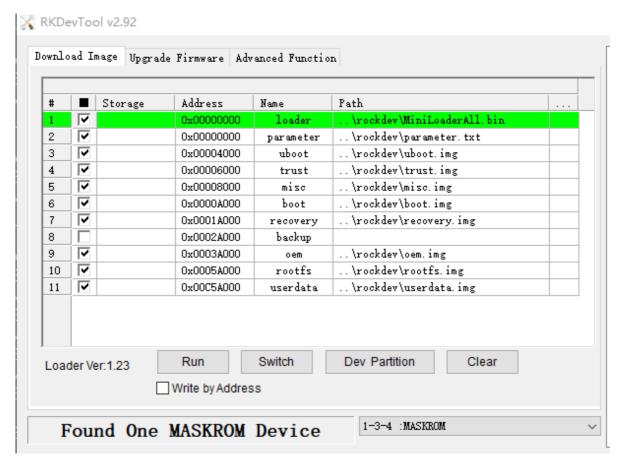


5.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.92 或以上),工具位于工程根目录:

tools/ |— windows/RKDevTool

如下图,编译生成相应的固件后,设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式,连接好 USB 下载线后,按住按键 "MASKROM" 不放并按下复位键 "RST" 后松手,就能进入 MASKROM 模式,加载编译生成固件的相应路径后,点击 "执行" 进行烧写,也可以按 "recovery" 按键不放并按下复位键 "RST" 后松手进入 loader 模式进行烧写,下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.12.zip

5.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V2.1 或以上),请确认你的 板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下,升级命令如下:

```
sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin -noreset
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rocdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件:

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录, 机器在 MASKROM 状态运行如下升级:

```
./rkflash.sh
```

5.3 系统分区说明

默认分区说明(下面是 RK3358 EVB 分区参考)

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	trust
3	32768	40959	4096K	misc
4	40960	106495	32M	boot
5	106496	303104	32M	recovery
6	172032	237567	32M	bakcup
7	237568	368639	64M	oem
8	368640	12951551	6144M	rootfs
9	12951552	30535646	8585M	userdata

• uboot 分区:供 uboot 编译出来的 uboot.img。

• trust 分区:供 uboot 编译出来的 trust.img。

• misc 分区:供 misc.img,给 recovery 使用。

• boot 分区:供 kernel 编译出来的 boot.img。

• recovery 分区:供 recovery 编译出的 recovery.img。

• backup 分区: 预留, 暂时没有用, 后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。

• oem 分区:给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。

• rootfs 分区: 供 buildroot、debian 或 yocto 编出来的 rootfs.img。

• userdata 分区:供 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。

6. 快速启动

常规启动流程大多经过以下过程: miniloader -> uboot -> kernel -> rootfs -> app,故只需要对上述的各个流程的启动进行优化,便能够实现快速启动。本章主要介绍 RK3358 快速启动的调优方法和注意事项。

典型的优化方式如下:

- kernel 和 rootfs 通过 SPL 方式加载, 裁减掉 uboot;
- kernel 配置进行针对性的裁减,减少无用配置,缩小 kernel 体积;
- · rootfs 根据应用场景需要进行裁减,缩小体积;

对于 kernel,可以开启 init_debug,即 CONFIG_PRINTK_TIME 和 CONFIG_KALLSYMS 配置,通过 kernel/scripts/bootgraph.pl,分析 kernel 启动时间的分布,针对性地优化耗时的模块,耗时长的驱动可以通过模块的方式在 rootfs 启动后加载。

对于 rootfs, 需要根据应用的场景进行构建, 可以从工具链、C库、GUI 等方向进行选择, 如:

- 更高版本的 gcc 和 binutils 往往会有更好的优化功能;
- 标准且最全面的 glibc 可以根据需要替换成可配置且体积小的 musl;
- rootfs 默认集成的 wayland weston, 可以根据需要替换成 LVGL 等其他框架;

• 裁减 rootfs 大小, 去除无用的启动服务和后台服务;

7. OTP

OTP (One Time Programmable),即只可编程一次的非易失性存储。作为对比,FLASH 存储可多次擦写。RK3358 的 OTP SIZE 为 64 bytes。OTP 相关开发的详细说明可以参考文档/docs/Linux/Security/Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN.pdf。

8. RK3358 SDK 固件

• 百度云网盘

Buildroot

• 微软 OneDriver

Buildroot